

5-103911-8 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU System 50

TE 内部编号 5-103911-8

PCB Mount Receptacle, Right Angle, Board-to-Board, 100 Position,  
1.27 mm [.05 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal,  
AMPMODU System 50

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 100

行数: 2

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: 直角

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

### 结构特性

板对板配置	正交
位数	100
行数	2
PCB 安装方向	直角

### 电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	30 VAC

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性

接合方柱尺寸	.38 mm[.015 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子布局	矩阵



端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
--------------	-----------------

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	铜合金
------	-----

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子类型	母端
------	----

端子额定电流（最大值）	3.6 A
-------------	-------

### 端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.4 mm[.016 in]
-------------	----------------

矩形端接柱体和尾部宽度	.2 mm[.008 in]
-------------	----------------

端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]
------------	----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

### 机械附件

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

PCB 安装固定类型	压具柱体
------------	------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

### 壳体特性

外壳材料	LCP（液晶聚合物）
------	------------

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

### 尺寸

连接器长度	64.64 mm[2.54 in]
-------	-------------------

连接器高度	5.51 mm[.217 in]
-------	------------------

连接器宽度	11.1 mm[.437 in]
-------	------------------

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
------------	------------------

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

### 使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

焊接工艺特性	板支座
--------	-----

电路应用	Signal
------	--------

## 行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

## 包装特性

封装数量	8
封装方法	Tube

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMPMODU System 50



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

100 SYSTEM 50 RCPT ASSY DRRA

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D



**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-103911-8\\_V.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-103911-8\\_V.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-103911-8\\_V.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION3AND4](#)

英文版本

[AMPMODU SYSTEM 50 QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[AMPMODU SYSTEM 50](#)

英文版本

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本